## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

:

Yoshinori MAENO

Attn: APPLICATION BRANCH

Serial No. NEW

Tittle Titt Die Titte Die Titte Cit

Filed August 20, 2003

Attorney Docket No. 2003-1118A

MOUNTING METHOD FOR OPTICAL MEMBER AND OPTICAL MODULE

## **CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119**

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicant in the above-entitled application hereby claims the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. JP2002-246615, filed August 27, 2002, as acknowledged in the Declaration of this application.

By

A certified copy of said Japanese Patent Application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

Yoshinori MAENO

Nils E. Pedersen

Registration No. 33,145

Attorney for Applicant

NEP/krl Washington, D.C. 20006-1021 Telephone (202) 721-8200 Facsimile (202) 721-8250 August 20, 2003

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE FEES FOR THIS PAPER TO DEPOSIT ACCOUNT NO. 23-0975

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月27日

出願番号

Application Number:

特願2002-246615

[ ST.10/C ]:

[JP2002-246615]

出 願 人
Applicant(s):

沖電気工業株式会社

2003年 5月30日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



#### 特2002-246615

【書類名】

特許願

【整理番号】

KT000446

【提出日】

平成14年 8月27日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

G02B 5/32

G02B 3/00

G02B 6/42

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会

社内

【氏名】

前野 仁典

【特許出願人】

【識別番号】

000000295

【氏名又は名称】

沖電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100095957

【弁理士】

【氏名又は名称】

亀谷 美明

【電話番号】

03-5919-3808

【選任した代理人】

【識別番号】

100096389

【弁理士】

【氏名又は名称】

金本 哲男

【電話番号】

03-3226-6631

【選任した代理人】

【識別番号】

100101557

【弁理士】

【氏名又は名称】

萩原 康司

【電話番号】

03-3226-6631

## 特2002-246615

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 040224

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9707549

【包括委任状番号】 9707550

【包括委任状番号】 9707551

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学部材の実装方法および光モジュール

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学部材を支持基板に実装する光学部材の実装方法であって

前記光学部材の側面のうち、一部を前記支持基板に接触させて位置決めを行い 、他部は前記支持基板と非接触とし、前記非接触となる部分の一部と前記支持基 板との間に接着剤を充填して前記光学部材と前記支持基板とを接着することを特 徴とする光学部材の実装方法。

【請求項2】 光学基板の表面に列状に形成された複数の光束変換部と,前記複数の光束変換部のそれぞれの周辺の一部に沿う縁部を含んで張り出すよう前記光束変換部ごとに形成された張出部とを有する光学部材を支持基板に実装する光学部材の実装方法であって,

前記複数の張出部のうち、少なくとも1つの張出部の側面の一部を前記支持基板に接触させ、残りの張出部の側面は前記支持基板に非接触とすることを特徴とする光学部材の実装方法。

【請求項3】 前記支持基板に接触する張出部は前記列の両端に位置する張 出部であることを特徴とする請求項2に記載の光学部材の実装方法。

【請求項4】 前記非接触となる張出部の側面の一部と前記支持基板との間に接着剤を充填して前記光学部材と前記支持基板とを接着することを特徴とする請求項2または3に記載の光学部材の実装方法。

【請求項5】 支持基板と,

前記支持基板上に実装され,光束変換部を有する光学部材と,を具備し,

前記光学部材の側面のうち、一部は前記支持基板に接触し、他部は前記支持基板と非接触となるよう構成し、前記非接触となる部分の一部と前記支持基板との間に接着剤が充填されていることを特徴とする光モジュール。

【請求項6】 支持基板と、

前記支持基板上に実装され、光学基板の表面に列状に形成された複数の光束変換部と、前記光束変換部のそれぞれの周辺の一部に沿う縁部を含んで張り出すよ

う前記光束変換部ごとに形成された張出部とを有する光学部材と、を具備し,

前記複数の張出部のうち、少なくとも1つの張出部の側面の一部が前記支持基板に接触し、残りの張出部の側面は前記支持基板に非接触となるよう構成し、前記非接触となる残りの張出部の側面の一部と前記支持基板との間に接着剤が充填されていることを特徴とする光モジュール。

【請求項7】 前記支持基板は少なくとも1つの部材配置用の溝を有し、前記支持基板に接触する張出部は前記溝に接触し、前記非接触となる残りの張出部は前記溝に収納されることを特徴とする請求項6に記載の光モジュール。

【請求項8】 前記支持基板に接触する張出部は前記列の両端に位置する張出部であることを特徴とする請求項6または7に記載の光モジュール。

【請求項9】 前記光学部材はシリコン基板からなることを特徴とする請求項5から8のいずれか1項に記載の光モジュール。

【請求項10】 前記光束変換部は回折光学素子からなることを特徴とする 請求項5から9のいずれか1項に記載の光モジュール。

【請求項11】 前記光束変換部はレンズであることを特徴とする請求項5 から10のいずれか1項に記載の光モジュール。

【請求項12】 前記支持基板はシリコン基板からなることを特徴とする請求項5から11のいずれか1項に記載の光モジュール。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、光通信機器またはコンピュータのデバイスとして使用されるのに好適な光学部材の実装方法および該光学部材を用いた光モジュールに関するものである。

[0002]

#### 【従来の技術】

回折光学素子を用いたマイクロレンズや微小光学素子がCD等の光ディスク再生装置や光通信用の光学部材として使用されている。このようなマイクロレンズは、例えば円筒形状や蒲鉾型の形状をしている。この種の光学部材は例えばシリ

コン基板上にレンズ等の所望の形状をフォトリソグラフィ工程で形成した後,エッチングを行うことにより製造される。これらのマイクロレンズや微小光学素子の大きさは100μm~数百μm角程度である。

[0003]

通常、光学部材はシリコン等の支持基板上に配置されて使用される。支持基板には、エッチングあるいは切削加工により形成された断面がV字形のV溝や、半導体レーザ配置用のテラス、V溝より大きな光学部品配置用の溝等が設けられている。これらのV溝、テラス、溝等を高精度に形成し、また配置される光学部材の外形をあらかじめ高精度に形成し、これらの部材をV溝等にサブミクロン精度で配置することにより、高精度な実装が可能となる。光学部材の配置にはボンダと呼ばれる部品配置装置を用いられる。

[0004]

上記のシリコン基板からなる光学部材を用いて光モジュールを作製する場合も一般に、シリコン支持基板上に形成されたV溝にこの光学部材を配置して固定する実装方法を採用する。固定の方法としては、接着剤や半田等を用いる方法が一般的である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記実装方法では通常、V溝に光学部材が当接するよう配置することにより位置決めを行い、この当接している部分を接着して固定していた。 このため、接着剤の厚みにより光学部材の取付位置がずれてしまい、位置決めが 正確に行われず、実装精度が低くなるという問題があった。

[0006]

また、上記分野の光学部材の1つとして例えば図14に示すようなレンズアレイ91がある。このレンズアレイ91は複数のレンズ部92が一体化されたものであり、光学基板の表面に列状に形成された複数のレンズ部92と、レンズ部92の外周の上部側で全レンズ部92を接続して一体化する取扱・支持部94を主に有する。各レンズ部92の外周の下部には縁部93が形成され、縁部93は各レンズ部92の円周形状に沿った円弧形状を有する。この縁部93の円弧形状を

呈する外形はレンズ部92の形成面側からその対向面側まで延びており、略蒲鉾 形状の張出部96を形成している。

[0007]

図14はレンズアレイ91が支持基板902に実装された状態を示す。支持基板902には複数のV溝904が形成されており、V溝904の形状、間隔は張出部96の形状、間隔に対応している。レンズアレイ91の実装では、各V溝94に各張出部96が当接するよう配置され、これににより位置決めを行い、この当接部を接着して固定する。

[0008]

しかし、この実装方法では上述のような接着剤の厚みによる位置決めの誤差の問題だけでなく、以下のような問題も生じていた。この実装方法では、各張出部96が各V溝904に適合するように、全ての張出部96の外形寸法が既定値内となるよう精度良く形成する必要がある。例えば製造工程においてレンズアレイ91の複数ある張出部96のうちの1つでもその外形寸法が既定値よりも大きくなった場合には、レンズアレイ91を適正な位置に実装することができないため、その製品は不良品となり、歩留まりが低下する要因となる。

[0009]

本発明の目的は、このような問題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、高精度な実装と歩留まりの向上が可能な光学部材の実装方法および 高精度に実装された光モジュールを提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明の第1の観点によれば、光学部材を支持基板に実装する光学部材の実装方法であって、前記光学部材の側面のうち、一部を前記支持基板に接触させて位置決めを行い、他部は前記支持基板と非接触とし、前記非接触となる部分の一部と前記支持基板との間に接着剤を充填して前記光学部材と前記支持基板とを接着することを特徴とする光学部材の実装方法が提供される。

[0011]

かかる構成によれば、位置決めを行う部分と接着を行う部分が異なるため、接着剤の厚みによる位置決めの誤差が生じることがなく、高精度な実装が可能になる。

## [0012]

また、本発明の第2の観点によれば、光学基板の表面に列状に形成された複数の光束変換部と、前記複数の光束変換部のそれぞれの周辺の一部に沿う縁部を含んで張り出すよう前記光束変換部ごとに形成された張出部とを有する光学部材を支持基板に実装する光学部材の実装方法であって、前記複数の張出部のうち、少なくとも1つの張出部の側面の一部を前記支持基板に接触させ、残りの張出部の側面は前記支持基板に非接触とすることを特徴とする光学部材の実装方法が提供される。

#### [0013]

かかる構成によれば、複数の張出部のうち、支持基板に接触する張出部のみ既 定値内の精度をもつよう形成しておけば、この張出部を用いて高精度に位置決め を行うことが可能である。支持基板に接触しない他の張出部は既定値内の精度を もつほど高精度に形成する必要はないため、歩留まりの向上が期待できる。

#### [0014]

その際に、前記支持基板に接触する張出部は前記列の両端に位置する張出部であるように構成してもよい。また、前記非接触となる張出部の側面の一部と前記支持基板との間に接着剤を充填して前記光学部材と前記支持基板とを接着してもよい。かかる構成によれば、位置決めを行う部分と接着を行う部分が異なるため、接着剤の厚みによる位置決めの誤差が生じることがなく、高精度な実装が可能になる。

#### [0015]

本発明の第3の観点によれば、支持基板と、前記支持基板上に実装され、光束 変換部を有する光学部材と、を具備し、前記光学部材の側面のうち、一部は前記 支持基板に接触し、他部は前記支持基板と非接触となるよう構成し、前記非接触 となる部分の一部と前記支持基板との間に接着剤が充填されていることを特徴と する光モジュールが提供される。

## [0016]

かかる構成によれば、接触している部分で位置決めを行うことができ、位置決めを行う部分と接着を行う部分が異なるため、接着剤の厚みによる位置決めの誤差が生じることがない。よって、高精度に実装された光モジュールを提供できる

## [0017]

また、本発明の第4の観点によれば、支持基板と、前記支持基板上に実装され、光学基板の表面に列状に形成された複数の光束変換部と、前記光束変換部のそれぞれの周辺の一部に沿う縁部を含んで張り出すよう前記光束変換部ごとに形成された張出部とを有する光学部材と、を具備し、前記複数の張出部のうち、少なくとも1つの張出部の側面の一部が前記支持基板に接触し、残りの張出部の側面は前記支持基板に非接触となるよう構成し、前記非接触となる残りの張出部の側面の一部と前記支持基板との間に接着剤が充填されていることを特徴とする光モジュールが提供される。

#### [0018]

かかる構成によれば、複数の張出部のうち、支持基板に接触する一部の張出部のみ既定値内の精度をもつよう形成しておけば、この張出部を用いて高精度に位置決めを行うことが可能である。支持基板に接触しない他の張出部は既定値内の精度をもつよう高精度に形成する必要はないため、歩留まりの向上が期待できる。また、接触している部分で位置決めを行うことができ、位置決めを行う部分と接着を行う部分が異なるため、接着剤の厚みによる位置決めの誤差が生じることがない。よって、高精度に実装された光モジュールを提供できる。

#### [0019]

その際に、前記支持基板は少なくとも1つの部材配置用の溝を有し、前記支持 基板に接触する張出部は前記溝に接触し、前記非接触となる残りの張出部は前記 溝に収納されるよう構成することが好ましい。また、前記支持基板に接触する張 出部は前記列の両端に位置する張出部であるように構成してもよい。

#### [0020]

上記記載において、光束変換部とは光束を変換する機能を有するものであり、

例えば光束を収束,発散,反射,偏向等するものである。また,光束変換部は,配置条件により入射光束を平行光に変換するものも含む。光束変換部の具体例としては、レンズや,回折光学素子からなる素子等が挙げられる。

[0021]

なお、光学部材に用いる光学基板は例えばシリコン結晶基板を用いることができる。その他の結晶基板としては、GaAs, InP, GaP, SiC, Ge等を材料とする基板が挙げられる。また、支持基板にもシリコン結晶基板を用いることができる。

[0022]

## 【発明の実施の形態】

以下,図面に基づいて本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお,以下の説明および添付図面において,略同一の機能および構成を有する構成要素については,同一符号を付すことにより,重複説明を省略する。図1は本発明の第1の実施の形態にかかる光モジュールに用いられる光学部材としてのレンズアレイの構成を示す斜視図である。図2および図3は本発明の第1の実施の形態にかかる光モジュールの構成を示す図である。

[0023]

まず図1を参照しながら、レンズアレイ1の構成について説明する。レンズアレイ1は光学基板からなり、図14に示したレンズアレイ91と同様の構成を有するものである。レンズアレイ1は、光学基板の表面に列状に形成された5つのレンズ部2a,2b,2c,2d,2eと、5つの縁部3a,3b,3c,3d,3eと、バー形状の取扱・支持部4と、略蒲鉾形の5つの張出部6a,6b,6c,6d,6eと、を主に有する。

[0024]

図1では、最も左側のレンズ部から右側に向かって順に2a, 2b, 2c, 2d, 2eの符号を付している。縁部および張出部に関しても同様に、図1で最も左側のものから右側に向かって順に3a, 3b, 3c, 3d, 3eおよび6a, 6b, 6c, 6d, 6eの符号を付している。

[0025]

なお、ここでは5つのレンズ部2a、2b、2c、2d、2eは同様の構成を有しており、場合に応じて、レンズ部2a、2b、2c、2d、2eを総称してレンズ部2と記述する。縁部および張出部に関しても同様に、場合に応じて、張出部6a、6b、6c、6d、6eを総称して張出部6、縁部3a、3b、3c、3d、3eを総称して縁部3と記述する。

[0026]

レンズ部2はここでは円形形状をしており、回折光学素子からなる。レンズ部2は8位相のバイナリ型の回折光学素子であり、フォトリソグラフィーとエッチングを3回繰り返すことにより作製される。なお、ここではレンズ部2の光軸はレンズ部2の表面に垂直な方向にあるものとする。

[0027]

レンズ部2それぞれの下部側にはレンズ部2の外周の一部としての縁部3がそれぞれ位置し、縁部3のそれぞれはレンズ部2の円周形状に沿った円弧形状を有する。この縁部3のそれぞれの円弧形状を呈する外形はレンズ部2の形成面側からその対向面側まで延びており、縁部3のそれぞれを含んで取扱・支持部4から下方に張り出す略蒲鉾形状の張出部6をそれぞれ形成している。例えば、レンズ部2aの外周の一部に縁部3aが位置し、縁部3aの円弧形状を呈する外形を含んで張出部6aが構成されている。レンズ部2b,2c,2d,2eについても同様に、縁部と張出部が形成されており、図1に示すようにレンズ部2a,2b,2c,2d,2eに対応する縁部および張出部はそれぞれ3a,3b,3c,3d,3eおよび6a,6b,6c,6d,6eとなる。

[0028]

張出部6はレンズアレイ1を実装する際に、位置決めや接着固定に用いられる 部分である。張出部6のこの円弧形状の外径寸法はレンズアレイ1と光結合する 光ファイバの外径寸法と等しくなるよう構成することが好ましく、ここでは一例 としてその外径寸法をφ125μmとする。

[0029]

取扱・支持部4は、図1に示す通り、レンズ部2の外周の上部側でレンズ部2 と接続し、レンズ部2の表面に略平行な面上でレンズ部2を越えてレンズ部2の 列方向に沿って伸長し、レンズ部2を接続して一体化するように形成されている。取扱・支持部4の上面および側面は平坦に形成されている。したがって、上方あるいは側方から保持手段によりレンズアレイ1を保持することが容易である。保持手段としては例えば、挟持手段や吸引保持する負圧吸盤のような負圧保持手段が考えられる。

## [0030]

レンズアレイ1は、フォトリソグラフィーによりシリコン基板上に塗布したレジストを所望の形状にパターン加工し、このレジストをドライエッチング用のエッチングマスクとして使用し、レジスト形状をシリコン基板に転写することで作製される。ここで用いられるドライエッチングの手法としては、RIE (反応性イオンエッチング法) あるいはICP-Bosch法等が採用できる。例えばパターン加工されるシリコン基板としてSOI (シリコン オン インシュレータ) 基板を用い、ICP-Bosch法により基板のシリコン酸化膜層までエッチングし、次にこのシリコン基板からフッ化水素酸溶液を用いてシリコン酸化層を除去することにより、レンズアレイ1を作製することができる。レンズアレイ1の厚さは100μmである。

#### $[0\ 0.3\ 1]$

次に図2および図3を参照しながら第1の実施の形態にかかる光モジュール100の構成および実装方法について説明する。図2(a)は光モジュール100の断面図であり、その断面位置をA-A'として図2(b)に示す。断面位置A-A'はレンズアレイ1のレンズ部2形成面が配置される位置とほぼ一致している。図2(b)は光モジュール100の上面図である。図3は光モジュール100の構成を説明するための斜視図である。

#### [0032]

光モジュール100は,支持基板102と,支持基板102上に実装されたレンズアレイ1と,5つのレーザダイオード13a,13b,13c,13d,13e,5本の光ファイバ15a,15b,15c,15d,15eとを有する。図2では,最も左側のレーザダイオードから右側に向かって順に13a,13b,13c,13d,13eの符号を付し,光ファイバについても同様に最も左側

のものから右側に向かって順に15a, 15b, 15c, 15d, 15eの符号を付している。場合に応じて、これら5つのレーザダイオード13a, 13b, 13c, 13d, 13eを総称してレーザダイオード13と記述し、これら5つの光ファイバ15a, 15b, 15c, 15d, 15eを総称して光ファイバ15と記述する。光ファイバ15の外径寸法はφ125μmである。

## [0033]

図2において、レンズ部2の列方向を×方向とし、紙面内の×方向に垂直な方向をy方向とする。5つのレーザダイオード13および5本の光ファイバ15はそれぞれ×方向に並列配置されている。また、y方向には1つのレーザダイオードと1つのレンズ部と1本の光ファイバとがこの順に同一光軸を有するように配置されて、1つの組を構成している。例えば、レーザダイオード13aとレンズ部2aと光ファイバ15aとは同一光軸を有するように配置されて、1つの組を構成している。このような構成の組が5つ×方向に並列に配置されている。

## [0034]

支持基板102は、例えばシリコン結晶基板からなる。支持基板102は、断面形状がV字状の5つのV溝104a、104b、104c、104d、104eと、断面形状が略台形状の凹溝106とを有する。3つのV溝104b、104c、104dと凹溝106は連通している。図2では、最も左側のV溝から右側に向かって順に104a、104b、104c、104d、104eの符号を付している。場合に応じて、これら5つのV溝104a、104b、104c、104d、104eを総称してV溝104と呼ぶ。図2(b)ではV溝104および凹溝106を斜線部で示す。なお、図3では溝を明示するためにレンズアレイ1を実装する前の状態を示し、レーザダイオードの図示は省略している。

#### [0035]

5つのV溝104はy方向を伸長方向とする溝であり、支持基板102の上面に互いに平行にx方向に並列に形成されている。5つのV溝104は全て支持基板102の一端から形成されているが、それらのy方向の長さは一様ではない。 V溝104b, 104c, 104dのy方向の長さはV溝104a, 104eのy方向の長さより短く、V溝104b, 104c, 104dのy方向の終端は凹 溝106と接続されている。凹溝106はx方向を長軸方向とする溝である。凹溝106のy方向の終端位置とV溝104a,104eのy方向の終端位置がほぼ一致するよう構成されている。

[0036]

V溝104のそれぞれは、レンズアレイ1の張出部6の1つまたは光ファイバ 15の1つを載置可能な寸法を有する。また、凹溝106は図2(a)に示すよ うにレンズアレイ1の張出部6のうちの3つを凹溝106の内壁に非接触に収納 可能となるよう構成されている。

[0037]

レンズアレイ1を支持基板102上に実装する際には以下のように行う。レンズアレイ1の両端の張出部6a, 6eが支持基板102のV溝104a, 104eに配置され、レンズアレイ1の張出部6b, 6c, 6dが支持基板102の凹溝106に配置されるようにする。このとき、図2(a)に示すように、張出部6a, 6eの側面の一部はそれぞれV溝104a, 104eの側壁に当接して、レンズアレイ1と支持基板102は計4箇所で線接触するので、これによって光軸に垂直な方向の位置決めを行う。レンズアレイの取り付け位置精度は、張出部6a, 6eの加工精度により決定され、ICP-Bosch法を用いた加工ではその精度は±0.5μmである。

[0038]

このとき、張出部6b、6c、6dは凹溝106に収納され、これら3つの張出部の側面は支持基板102と接触していない。張出部6b、6c、6dの下部と凹溝106の底面との間には間隙があり、この間隙に接着剤108を充填し、これによってレンズアレイ1を支持基板102に接着し固定する。接着剤108は例えば樹脂系熱硬化接着剤や樹脂系UV硬化接着剤を用いることができる。

[0039]

また、支持基板102上において、レンズアレイ1に対し溝と反対側にレンズ 部2a, 2b, 2c, 2d, 2eと光軸を共有するようにレーザダイオード13a, 13b, 13c, 13d, 13eそれぞれを配置する。5つのV溝104a, 104b, 104c, 104d, 104eには、図2(b) に示すように、そ

れぞれ5本の光ファイバ15a, 15b, 15c, 15d, 15eを配置する。 以上の構成により、図2(b)に示すように、1つのレーザダイオードと1つの レンズ部と1本の光ファイバとが光学的に結合した組を5つ有する光モジュール 100が形成される。

#### [0040]

上記構成を有する光モジュール100の動作について説明する。レーザダイオード13のそれぞれから出射した光は、レンズアレイ1に入射し、光学的に結合した組のレンズ部2により集光作用を受け、光学的に結合した組の光ファイバ15の端面上に集光され、伝送される。一例をあげると、レーザダイオード13aから出射した光は、レンズアレイ1に入射し、レンズ部2aにより集光作用を受け、光ファイバ15aの端面上に集光され、伝送される。

#### [0041]

以上説明したように、本実施の形態によれば、レンズアレイ1の実装の際の位置決めには両端の2つの張出部6a、6eを用いている。よって、この2つの張出部6a、6eの作製精度が既定値以内であれば、適正な位置にレンズアレイ1を配置可能となる。他の3つの張出部6b、6c、6dの作製精度が既定値外である場合でも、それを理由として製品が不良品となることはない。従来の実装方法では、5つの張出部全てに作製精度が既定値以内であることが要求されるが、本実施の形態では2つの張出部のみの作製精度が既定値以内であればよいため、歩留まりの向上に大きく貢献できる。

#### [0042]

また、レンズアレイ1と支持基板102との接着には、張出部6b,6c,6 dを用いている。このように、レンズアレイ1の接着部分をレンズアレイ1の位置決めを行う部分とは異なるように構成することにより、接着剤の塗布に関らず正確にレンズアレイ1を実装すべき位置を決定することが可能となり、実装精度の向上を図ることができる。

#### [0043]

次に図4および図5を参照しながら第2の実施の形態にかかる光モジュール2 00の構成および実装方法について説明する。光モジュール200は、第1の実 施の形態における支持基板102とレンズアレイ1を,支持基板202とレンズアレイ21に置き換えた構成を有する。以下,この点に注目して説明し,第1の 実施の形態と同様の構成については,重複説明を省略する。

## [0044]

図4 (a) は光モジュール200の断面図であり、その断面位置をB-B'として図4 (b) に示す。断面位置B-B'はレンズアレイ21のレンズ部形成面が配置される位置とほぼ一致している。図4 (b) は光モジュール200の上面図である。図5は光モジュール200の構成を説明するための斜視図である。なお、レンズ部の列方向をx方向とし、紙面内のx方向に垂直な方向をy方向とする。

#### [0045]

レンズアレイ21では、レンズアレイ1のレンズ部2a, 2b, 2c, 2d, 2eに代わり、ブレーズ型の回折光学素子からなるレンズ部22a, 22b, 2 2c, 22d, 22eがそれぞれ形成されている。その他の点についてはレンズアレイ21は図1に示すレンズアレイ1と同様の構成を有し、縁部、張出部、取扱・支持部4を有する。ここで、レンズアレイ21におけるレンズ部22a, 2 2b, 22c, 22d, 22eに対応する張出部をそれぞれ26a, 26b, 2 6c, 26d, 26eとする。場合に応じて、レンズ部22a, 22b, 22c, 22d, 22eを総称してレンズ部22と記述し、張出部26a, 26b, 2 6c, 26d, 26eを総称して吸出部26と記述する。レンズアレイ21、レンズ部22の作製はレンズアレイ1、レンズ部2の場合と同様の方法を用いて行うことができる。

#### [0046]

支持基板202は、溝の構成が支持基板102と異なる。支持基板202は、断面形状がV字状の5つのV溝204a、204b、204c、204d、204eと、断面形状が略台形状の凹溝206とを有する。図4では、最も左側のV溝から右側に向かって順に204a、204b、204c、204d、204eの符号を付しており、場合に応じて、これら5つのV溝を総称してV溝204と呼ぶ。5つのV溝204と凹溝206は連通している。図4(b)ではV溝20

4 および凹溝206を斜線部で示す。なお、図5では溝を明示するためにレンズ アレイ21を実装する前の状態を示し、レーザダイオードの図示は省略している

#### [0047]

5つのV溝204はy方向を伸長方向とする溝であり、支持基板102の上面に互いに平行にx方向に並列に形成されている。5つのV溝204は全て支持基板202の一端から形成されており、5つのV溝204のy方向の終端は凹溝206と接続されている。凹溝206はx方向を長軸方向とする溝である。

## [0048]

V溝204のそれぞれは、光ファイバ15の1つを載置可能な寸法を有する。また、凹溝206は図4(a)に示すようにレンズアレイ21の5つの張出部26を収納可能であり、凹溝206の側壁に両端の張出部26a、26eが接触し、張出部26b、26c、26dは凹溝206の内壁に非接触となるよう構成されている。

### [0049]

レンズアレイ21を支持基板202上に実装する際には以下のように行う。レンズアレイ21の5つの張出部26が支持基板202の凹溝206に配置されるようにする。このとき,図4(a)に示すように,張出部26a,26eの側面の一部はそれぞれ凹溝206の側壁に当接して,レンズアレイ21と支持基板202は計2箇所で線接触するので,これによって光軸に垂直な方向の位置決めを行う。レンズアレイの取り付け位置精度は,張出部26a,26eの加工精度により決定され,ICP-Bosch法を用いた加工ではその精度は±0.5 $\mu$  m である。

#### [0050]

このとき、張出部26b,26c,26dは凹溝206に収納され、これら3つの張出部の側面は支持基板202と接触していない。張出部26b,26c,26dの下部と凹溝206の底面との間には間隙があり、この間隙に接着剤108を充填し、これによってレンズアレイ21を支持基板202に接着し固定する

#### [0051]

また、支持基板202上において、レンズアレイ21に対し溝と反対側にレンズ部22a、22b、22c、22d、22eと光軸を共有するようにレーザダイオード13a、13b、13c、13d、13eそれぞれを配置する。5つのV溝204a、204b、204c、204d、204eには、図4(b)に示すように、それぞれ5本の光ファイバ15a、15b、15c、15d、15eを配置する。以上の構成により、図4(b)に示すように、1つのレーザダイオードと1つのレンズ部と1本の光ファイバとが光学的に結合した組を5つ有する光モジュール200が形成される。

## [0052]

上記構成を有する光モジュール200の動作について説明する。レーザダイオード13のそれぞれから出射した光は、レンズアレイ21に入射し、光学的に結合した組のレンズ部22により集光作用を受け、光学的に結合した組の光ファイバ15の端面上に集光され、伝送される。

#### [0053]

以上説明したように、本実施の形態によれば、レンズアレイ21の実装の際の位置決めには両端の2つの張出部26a、26eを用いている。よって、この2つの張出部26a、26eの作製精度が既定値以内であれば、適正な位置にレンズアレイ21を配置可能となる。他の3つの張出部26b、26c、26dの作製精度が既定値外である場合でも、それを理由として製品が不良品となることはない。従来の実装方法では、5つの張出部全てに作製精度が既定値以内であることが要求されるが、本実施の形態では2つの張出部のみの作製精度が既定値以内であればよいため、歩留まりの向上に大きく貢献できる。

#### [0054]

また、レンズアレイ21と支持基板202との接着には、張出部26b,26c,26dを用いている。このように、レンズアレイ21の接着部分をレンズアレイ21の位置決めを行う部分とは異なるように構成することにより、接着剤の塗布に関らず正確にレンズアレイ21を実装すべき位置を決定することが可能となり、実装精度の向上を図ることができる。

[0055]

次に図6および図7を参照しながら第3の実施の形態にかかる光モジュール300の構成および実装方法について説明する。光モジュール300は,第1の実施の形態における支持基板102を支持基板302に置き換えた構成を有する。以下,この点に注目して説明し,第1の実施の形態と同様の構成については,重複説明を省略する。

[0056]

図6(a)は光モジュール300の断面図であり、その断面位置をC-C'として図6(b)に示す。断面位置C-C'はレンズアレイ1のレンズ部2形成面が配置される位置とほぼ一致している。図6(b)は光モジュール300の上面図である。図7は光モジュール300の構成を説明するための斜視図である。なお、レンズ部の列方向をx方向とし、紙面内のx方向に垂直な方向をy方向とする。

[0057]

支持基板302は,溝の構成が支持基板102と異なる。支持基板302は,断面形状がV字状の5つのV溝304a,304b,304c,304d,304eと,断面形状が略台形状の凹溝306とを有する。図6では,最も左側のV溝から右側に向かって順に304a,304b,304c,304d,304eの符号を付しており,場合に応じて,これら5つのV溝を総称してV溝304と呼ぶ。4つのV溝304b,304c,304d,304eと凹溝206は連通している。図6(b)ではV溝304および凹溝306を斜線部で示す。なお,図7では溝を明示するためにレンズアレイ1を実装する前の状態を示し,レーザダイオードの図示は省略している。

[0058]

5つのV溝304はy方向を伸長方向とする溝であり、支持基板302の上面に互いに平行にx方向に並列に形成されている。5つのV溝304は全て支持基板302の一端から形成されているが、それらのy方向の長さは一様ではない。 V溝304b,304c,304d,304eのy方向の長さはV溝304aのy方向の長さより短く、V溝304b,304c,304d,304eのy方向 の終端は凹溝306と接続されている。凹溝306はx方向を長軸方向とする溝である。凹溝306のy方向の終端位置とV溝304aのy方向の終端位置がほぼ一致するよう構成されている。

[0059]

V溝304のそれぞれは、レンズアレイ1の張出部6の1つまたは光ファイバ15の1つを載置可能な寸法を有する。また、凹溝306は図2(a)に示すようにレンズアレイ1の張出部6のうちの4つを収納可能であり、そのうち1つが凹溝306の側壁に接触した場合には残りの3つは凹溝306の内壁に非接触となるよう構成されている。

[0060]

レンズアレイ1を支持基板302上に実装する際には以下のように行う。レンズアレイ1の張出部6aが支持基板302のV溝304aに配置され,レンズアレイ1の張出部6b,6c,6d,6eが支持基板302の凹溝306に配置されるようにする。このとき,図6(a)に示すように,張出部6a,6eの側面の一部はそれぞれV溝304a,凹溝306の側壁に当接して,レンズアレイ1と支持基板302は計3箇所で線接触するので,これによって光軸に垂直な方向の位置決めを行う。レンズアレイの取り付け位置精度は,張出部6a,6eの加工精度により決定され,ICP-Bosch法を用いた加工ではその精度は±0.5 $\mu$ mである。

[0061]

このとき、張出部6b、6c、6dは凹溝306に収納され、これら3つの張出部の側面は支持基板302と接触していない。張出部6b、6c、6dの下部と凹溝306の底面との間には間隙があり、この間隙に接着剤108を充填し、これによってレンズアレイ1を支持基板302に接着し固定する。

[0062]

また、支持基板302上において、レンズアレイ1に対し溝と反対側にレンズ 部2a, 2b, 2c, 2d, 2eと光軸を共有するようにレーザダイオード13a, 13b, 13c, 13d, 13eそれぞれを配置する。5つのV溝304a, 304b, 304c, 304d, 304eには、図6(b)に示すように、そ

れぞれ5本の光ファイバ15a, 15b, 15c, 15d, 15eを配置する。 以上の構成により、図6(b)に示すように、1つのレーザダイオードと1つの レンズ部と1本の光ファイバとが光学的に結合した組を5つ有する光モジュール 300が形成される。

[0063]

上記構成を有する光モジュール300の動作について説明する。レーザダイオード13のそれぞれから出射した光は、レンズアレイ1に入射し、光学的に結合した組のレンズ部2により集光作用を受け、光学的に結合した組の光ファイバ15の端面上に集光され、伝送される。

[0064]

以上説明したように、本実施の形態によれば、レンズアレイ1の実装の際の位置決めには両端の2つの張出部6a、6eを用いている。よって、この2つの張出部6a、6eの作製精度が既定値以内であれば、適正な位置にレンズアレイ1を配置可能となる。他の3つの張出部6b、6c、6dの作製精度が既定値外である場合でも、それを理由として製品が不良品となることはない。従来の実装方法では、5つの張出部全てに作製精度が既定値以内であることが要求されるが、本実施の形態では2つの張出部のみの作製精度が既定値以内であればよいため、歩留まりの向上に大きく貢献できる。

[0065]

また、レンズアレイ1と支持基板302との接着には、張出部6b,6c,6 dを用いている。このように、レンズアレイ1の接着部分をレンズアレイ1の位置決めを行う部分とは異なるように構成することにより、接着剤の塗布に関らず正確にレンズアレイ1を実装すべき位置を決定することが可能となり、実装精度の向上を図ることができる。さらに本実施の形態と第2の実施の形態を比較すると、本実施の形態では第2の実施の形態よりも線接触の箇所が多いためガタつきを防止でき、より高精度な実装が可能となる。

[0066]

次に図8および図9を参照しながら第4の実施の形態にかかる光モジュール4 00の構成および実装方法について説明する。光モジュール400は、第1の実 施の形態における支持基板102を支持基板402に置き換えた構成を有する。 以下、この点に注目して説明し、第1の実施の形態と同様の構成については、重 複説明を省略する。

[0067]

図8(a)は光モジュール400の断面図であり、その断面位置をD-D'として図8(b)に示す。断面位置D-D'はレンズアレイ1のレンズ部2形成面が配置される位置とほぼ一致している。図8(b)は光モジュール400の上面図である。図9は光モジュール400の構成を説明するための斜視図である。なお、レンズ部の列方向をx方向とし、紙面内のx方向に垂直な方向をy方向とする。

[0068]

支持基板402は、溝の構成が支持基板102と異なる。支持基板402は、断面形状がV字状の5つのV溝404a、404b、404c、404d、404eと、断面形状が略台形状の2つの凹溝406a、406bとを有する。図8では、最も左側のV溝から右側に向かって順に404a、404b、404c、404d、404eの符号を付しており、場合に応じて、これら5つのV溝を総称してV溝404と呼ぶ。V溝404a、404bと凹溝406aは連通し、V溝404d、404eと凹溝406bは連通している。図8(b)ではV溝404および凹溝406a、406bを斜線部で示す。なお、図9では溝を明示するためにレンズアレイ1を実装する前の状態を示し、レーザダイオードの図示は省略している。

[0069]

5つのV溝404はy方向を伸長方向とする溝であり、支持基板402の上面に互いに平行にx方向に並列に形成されている。5つのV溝404は全て支持基板402の一端から形成されているが、それらのy方向の長さは一様ではない。 V溝404a,404b,404d,404eのy方向の長さはV溝404cのy方向の長さより短く、V溝404a,404bのy方向の終端は凹溝406aと接続され、V溝404d,404eのy方向の終端は凹溝406bと接続されている。凹溝406a,406bはx方向を長軸方向とする溝である。凹溝40 6 a, 406 bのy方向の終端位置とV溝404 cのy方向の終端位置がほぼ一致するよう構成されている。

[0070]

V溝404のそれぞれは、レンズアレイ1の張出部6の1つまたは光ファイバ15の1つを載置可能な寸法を有する。また、凹溝406a、406bはそれぞれ図8(a)に示すようにレンズアレイ1の張出部6のうちの2つを収納可能であり、そのうち1つが凹溝の側壁に接触した場合には残りの1つは凹溝の内壁に非接触となるよう構成されている。

[0071]

レンズアレイ1を支持基板402上に実装する際には以下のように行う。レンズアレイ1の張出部6a,6bが支持基板302の凹溝406aに配置され、レンズアレイ1の張出部6cがV溝404cに配置され、レンズアレイ1の張出部6d,6eが支持基板402の凹溝406bに配置されるようにする。このとき図8(a)に示すように、張出部6aの側面の一部は凹溝406aの側壁に当接し、張出部6cの側面の一部はV溝404cの側壁に当接し、張出部6eの側面の一部は凹溝406bの側壁に当接して、レンズアレイ1と支持基板302は計4箇所で線接触するので、これによって光軸に垂直な方向の位置決めを行う。レンズアレイの取り付け位置精度は、張出部6cの加工精度により決定され、ICP-Bosch法を用いた加工ではその精度は±0.5μmである。

[0072]

このとき、張出部6a、6bは凹溝406aに収納され、張出部6d、6eは 凹溝406bに配置され、張出部6b、6dの側面は支持基板402と接触して いない。張出部6bの下部と凹溝406aの底面との間および、張出部6dの下 部と凹溝406bの底面との間には間隙があり、この間隙に接着剤108を充填 し、これによってレンズアレイ1を支持基板402に接着し固定する。

[0073]

また,支持基板402上において,レンズアレイ1に対し溝と反対側にレンズ部2a,2b,2c,2d,2eと光軸を共有するようにレーザダイオード13a,13b,13c,13d,13eそれぞれを配置する。5つのV溝404a

,404b,404c,404d,404eには,図8(b)に示すように,それぞれ5本の光ファイバ15a,15b,15c,15d,15eを配置する。以上の構成により,図8(b)に示すように,1つのレーザダイオードと1つのレンズ部と1本の光ファイバとが光学的に結合した組を5つ有する光モジュール400が形成される。

## [0074]

上記構成を有する光モジュール400の動作について説明する。レーザダイオード13のそれぞれから出射した光は、レンズアレイ1に入射し、光学的に結合した組のレンズ部2により集光作用を受け、光学的に結合した組の光ファイバ15の端面上に集光され、伝送される。

## [0075]

以上説明したように、本実施の形態によれば、レンズアレイ1の実装の際の位置決めには張出部6a,6c,6eを用いている。よって、この3つの張出部6cの作製精度が既定値以内であれば、適正な位置にレンズアレイ1を配置可能となる。他の2つの張出部6b,6dの作製精度が既定値外である場合でも、それを理由として製品が不良品となることはない。従来の実装方法では、5つの張出部全てに作製精度が既定値以内であることが要求されるが、本実施の形態では1つの張出部のみの作製精度が既定値以内であればよいため、歩留まりの向上に大きく貢献できる。

### [0076]

また、レンズアレイ1と支持基板402との接着には、張出部6b,6dを用いている。このように、レンズアレイ1の接着部分をレンズアレイ1の位置決めを行う部分とは異なるように構成することにより、接着剤の塗布に関らず正確にレンズアレイ1を実装すべき位置を決定することが可能となり、実装精度の向上を図ることができる。

#### [0077]

なお,本実施の形態では両端の張出部だけでなく中心の張出部も用いて位置決めを行っている。長尺のレンズアレイ等,変形しやすい光学部材を精度良く実装したい場合に有効である。

[0078]

次に図10および図11を参照しながら第5の実施の形態にかかる光モジュール500の構成および実装方法について説明する。光モジュール500は,第2の実施の形態におけるレンズアレイ21をレンズアレイ51に置き換えた構成を有する。以下,この点に注目して説明し,第2の実施の形態と同様の構成については,重複説明を省略する。

[0079]

図10(a)は光モジュール500の断面図であり、その断面位置をE-E'として図10(b)に示す。断面位置E-E'はレンズアレイ51のレンズ部形成面が配置される位置とほぼ一致している。図10(b)は光モジュール500の上面図である。図11は光モジュール500の構成を説明するための斜視図である。なお、レンズ部の列方向を×方向とし、紙面内の×方向に垂直な方向をy方向とする。なお、図11では溝を明示するためにレンズアレイ51を実装する前の状態を示し、レーザダイオードの図示は省略している。

[0080]

レンズアレイ51は、光学基板の表面に列状に形成された5つのレンズ部52a,52b,52c,52d,52eを有する。図10(a)では、最も左側のレンズ部から右側に向かって順に52a,52b,52c,52d,52eの符号を付している。場合に応じて、レンズ部52a,52b,52c,52d,52eを総称してレンズ部52と記述する。レンズアレイ51の外形はレンズアレイ1,21と異なり、レンズ部52形成面に平行な面内で略舟形の外形を有する

[0081]

レンズ部52はレンズ部2と同様に8位相のバイナリ型の回折光学素子であり , レンズ部2と同様に作製可能である。レンズアレイ51の作製にあたっては, シリコン基板上に列状にレンズ部52を形成した後,レンズ部52を含む長方形 状をシリコン基板からダイシング等により切削して分離する。そして,図10( a)に示す斜めの側面58a,58bを形成するように研磨加工して作製する。 側面58a,58bは支持基板202の凹溝206の側面と密着するよう形成さ れている。ここでは,レンズアレイ 5 1 の作製に用いたシリコン基板の厚みは 6 0 0  $\mu$  mであり,作製されたレンズアレイ 5 1 の厚みも 6 0 0  $\mu$  mである。なお,図ではレンズアレイ 5 1 とレンズアレイ 1 ,2 1 との厚みの相違は必ずしも正確に描かれていない。

## [0082]

レンズアレイ51を支持基板202上に実装する際には以下のように行う。レンズアレイ51の舟形の底部が支持基板202の凹溝206に配置されるようにする。このとき、図10(a)に示すように、側面58a、58bの一部はそれぞれ凹溝206の側壁に当接して、レンズアレイ51と支持基板202は計2箇所で面接触するので、これによって光軸に垂直な方向の位置決めを行う。レンズアレイの取り付け位置精度は、側面58a、58bの加工精度により決定され、その精度は $-0.7\mu$ mである。

## [0083]

このとき、レンズアレイ51の5つの舟形の底部は凹溝206に収納され、この底部の底面58cは支持基板202と接触していない。底面58cと凹溝206の底面との間には間隙があり、この間隙に接着剤108を充填し、これによってレンズアレイ51を支持基板202に接着し固定する。

#### [0084]

また、支持基板202上において、レンズアレイ51に対し溝と反対側にレンズ部52a、52b、52c、52d、52eと光軸を共有するようにレーザダイオード13a、13b、13c、13d、13eそれぞれを配置する。5つのV溝204a、204b、204c、204d、204eには、図10(b)に示すように、それぞれ5本の光ファイバ15a、15b、15c、15d、15eを配置する。以上の構成により、図10(b)に示すように、1つのレーザダイオードと1つのレンズ部と1本の光ファイバとが光学的に結合した組を5つ有する光モジュール500が形成される。

#### [0085]

上記構成を有する光モジュール500の動作について説明する。レーザダイオード13のそれぞれから出射した光は、レンズアレイ51に入射し、光学的に結

合した組のレンズ部52により集光作用を受け、光学的に結合した組の光ファイバ15の端面上に集光され、伝送される。

[0086]

以上説明したように、本実施の形態によれば、レンズアレイ51の実装の際の位置決めには2つの側面58a、58bを用いている。よって、この2つの側面58a、58bの作製精度が既定値以内であれば、適正な位置にレンズアレイ51を配置可能となる。

[0087]

また、レンズアレイ51と支持基板202との接着には、底面58cを用いている。このように、レンズアレイ51の接着部分をレンズアレイ51の位置決めを行う部分とは異なるように構成することにより、接着剤の塗布に関らず正確にレンズアレイ51を実装すべき位置を決定することが可能となり、実装精度の向上を図ることができる。さらに、本実施の形態では、前述の実施の形態に比べ、接着面を広くとることができるので、接着強度が強く、信頼性の高い高モジュールを提供することができる。

[0088]

なお、上記実施の形態ではレンズアレイを1つだけ用いた光モジュールについて説明したが、支持基板の溝の構成を変更することで2つ以上のレンズアレイを用いた光モジュールを構成することも可能である。この場合の例として、第2の実施の形態の変形例1、変形例2を図12、図13に示す。

[0089]

図12は変形例1としての光モジュール210の上面図である。光モジュール210は,第2の実施の形態におけるレンズアレイ21と支持基板202とを,2つのレンズアレイ21a,21bと支持基板212に置き換えた構成を有する。以下,この点に注目して説明し,第2の実施の形態と同様の構成については,重複説明を省略する。

[0090]

2つのレンズアレイ21a, 21bは共にレンズアレイ21と全く同じ構成を 有するレンズアレイである。レンズアレイ21aは、レーザダイオード側に、そ の各レンズ部が対応するレーザダイオードと対向するように配置されると共に, レンズアレイ21bは,光ファイバ側に,その各レンズ部が対応する光ファイバ の端面と対向するように配置されている。

## [0091]

支持基板212は、溝の構成が支持基板202と異なる。支持基板212は、 支持基板202に凹溝206に平行に凹溝206と同様の構成を有する凹溝21 6を追加した構成となっている。凹溝216の位置は凹溝206と光ファイバ1 5の端面との間に位置する。この場合、5つのV溝204は2つの凹溝206、 216と連通する。図12ではV溝204および凹溝206、216を斜線部で示す。

#### [0092]

第2の実施の形態と同様に、レンズアレイ21a、21bはそれぞれ凹溝206,216に配置され、レンズアレイ21a、21bそれぞれが有する両端の2つの張出部は凹溝に接触して位置決めが行われ、中央の3つの張出部は支持基板212との接着に用いられる。

## [0093]

この光モジュール210では、レーザダイオード13のそれぞれから出射した 光は、レンズアレイ21aに入射し、光学的に結合した組のレンズ部によりコリメートされ、コリメートされた光はレンズアレイ21bに入射して光学的に結合 した組の各レンズ部で集光作用を受け、光学的に結合した組の光ファイバ15の 端面上に集光され、伝送される。この変形例1においても第2の実施の形態と同様の効果が得られる。

#### [0094]

図13は変形例2としての光モジュール220の上面図である。光モジュール220は、上記変形例1における基板212を支持基板222に置き換えた構成を有する。以下、この点に注目して説明し、同様の構成については、重複説明を省略する。

## [0095]

支持基板222は、溝の構成が支持基板212と異なる。支持基板222は、

支持基板212における凹溝206と凹溝216の間も溝とし、凹溝206と凹溝216を統合して1つの大きな凹溝226を形成した構成となっている。この場合、5つのV溝204は凹溝226と連通する。凹溝226の断面形状は凹溝206同様、略台形形状である。図13ではV溝204および凹溝226を斜線部で示す。

## [0096]

レンズアレイ21a, 21bはそれぞれ凹溝226のy方向の両端面近傍に配置されている。第2の実施の形態と同様に、レンズアレイ21a, 21bはそれぞれが有する両端の2つの張出部は凹溝226に接触して位置決めが行われ、中央の3つの張出部は支持基板222との接着に用いられる。光モジュール220の動作は光モジュール210の動作と同様である。この変形例2においても第2の実施の形態と同様の効果が得られる。

## [0097]

なお、図12、図13に示すような2つのレンズアレイを用いた変形例の構成 は第2の実施の形態だけでなく、その他の実施の形態の場合にも適用可能である

#### [0098]

なお上記例では、レンズ部にバイナリ型回折光学素子やブレーズ型回折光学素子を用いたが、屈折型のレンズ部など、基板に作製可能な光学素子に適用可能である。また、レンズ部は、円形に限らず所望の形状で形成可能である。レンズ部、縁部、取扱・支持部、張出部等の形状は上記例に限定されず、様々な形状が考えられる。上記例ではレンズアレイとして5つのレンズ部を有するものを例にとり説明したが、これに限定するものではなく、レンズアレイが有するレンズ部の数は任意の数を採用できる。

#### [0099]

第1~第4の実施の形態において、レンズアレイの側面をエッチングする方法としてICP-Bosch法を用いたが、エッチングマスクの選択次第でICP-RIE法等の他のエッチングの手法も可能である。第5の実施の形態のように、エッチング加工後、研磨により形成したレンズアレイも適用可能である。レン

ズアレイの基板としてシリコン基板を用いて説明したが、通信波長帯で光学的に透明な基板であれば適用可能である。また、支持基板に形成された光ファイバを 実装するための溝は断面がV字型の溝としたが、光ファイバの保持に支障がなければ、略台形形状等の別の形状も採用可能である。

[0100]

上記例は発光素子であるレーザダイオードと光ファイバの結合を例にとり説明 したが、受光素子との結合に応用することも可能である。また、上記例では、光 東変換部をレンズ部、また光学素子の例としてレンズ素子を例にとり説明したが 、これに限定するものではない。

[0101]

以上、添付図面を参照しながら本発明にかかる好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

[0102]

#### 【発明の効果】

以上,詳細に説明したように本発明によれば,光学部材を実装する際,位置決めを行う部分と接着を行う部分が異なるため,接着剤の厚みによる位置決めの誤差が生じることがなく,高精度な実装が可能になる。また,光学部材において位置決めに用いる部分を従来の場合より少なくでき,既定価内の作製精度が要求される部分が減るため,歩留まりの向上に大きく貢献できる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の実施の形態に係るレンズアレイの構成を示す斜視図である。
- 【図2】 本発明の第1の実施の形態に係る光モジュールの構成を示す図であり、図2(a)は図2(b)の位置A-Aにおける断面図、図2(b)は光モジュールの上面図である。
  - 【図3】 本発明の第1の実施の形態に係る光モジュールの構成を説明する

ための斜視図である。

- 【図4】 本発明の第2の実施の形態に係る光モジュールの構成を示す図であり、図4 (a) は図4 (b) の位置B-B における断面図、図4 (b) は光モジュールの上面図である。
- 【図5】 本発明の第2の実施の形態に係る光モジュールの構成を説明するための斜視図である。
- 【図 6 】 本発明の第3の実施の形態に係る光モジュールの構成を示す図であり、図 6 (a) は図 6 (b) の位置C-C における断面図、図 6 (b) は光モジュールの上面図である。
- 【図7】 本発明の第3の実施の形態に係る光モジュールの構成を説明するための斜視図である。
- 【図8】 本発明の第4の実施の形態に係る光モジュールの構成を示す図であり、図8(a)は図8(b)の位置D-D における断面図、図8(b)は光モジュールの上面図である。
- 【図9】 本発明の第4の実施の形態に係る光モジュールの構成を説明する ための斜視図である。
- 【図10】 本発明の第5の実施の形態に係る光モジュールの構成を示す図であり、図10(a)は図10(b)の位置E-E における断面図、図10(b)は光モジュールの上面図である。
- 【図11】 本発明の第5の実施の形態に係る光モジュールの構成を説明するための斜視図である。
  - 【図12】 本発明の変形例1に係る光モジュールの上面図である。
  - 【図13】 本発明の変形例2に係る光モジュールの上面図である。
  - 【図14】 光学部材の1例を示す斜視図である。

#### 【符号の説明】

- 1,21,51 レンズアレイ
- 2 レンズ部
- 3 縁部
- 4 取扱・支持部

6,26 張出部

13 レーザダイオード

15 光ファイバ

58a, 58b 側面

58c 底面

100, 200, 300, 400, 500 光モジュール

104, 204, 304, 404 V溝

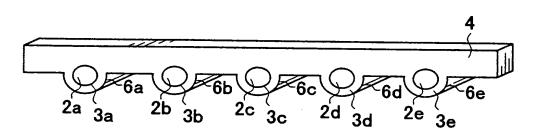
106, 206, 306, 406a, 406b 凹溝

108 接着剤

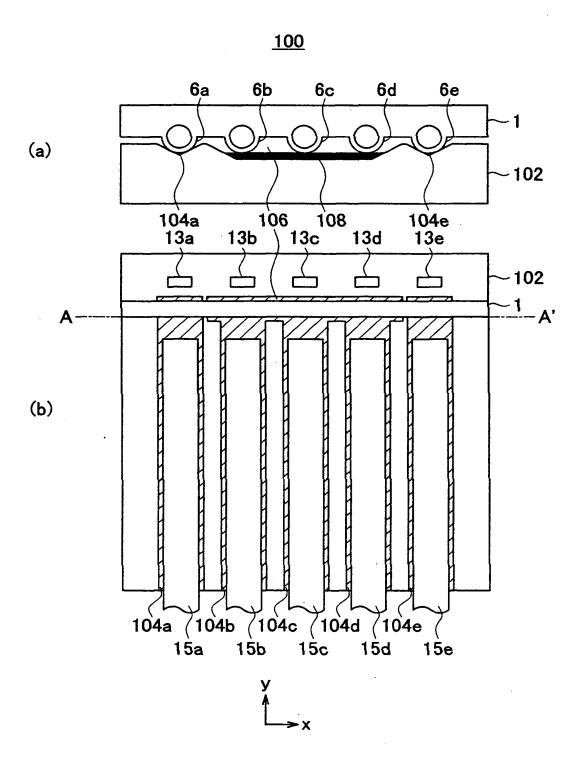
102,202,302,402 支持基板

【書類名】図面【図1】

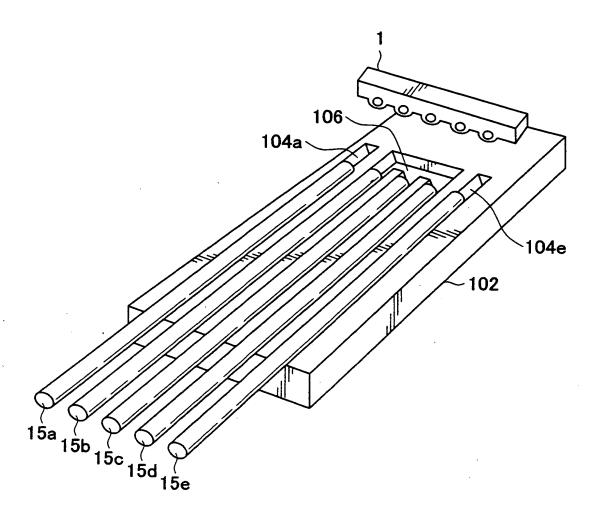
1



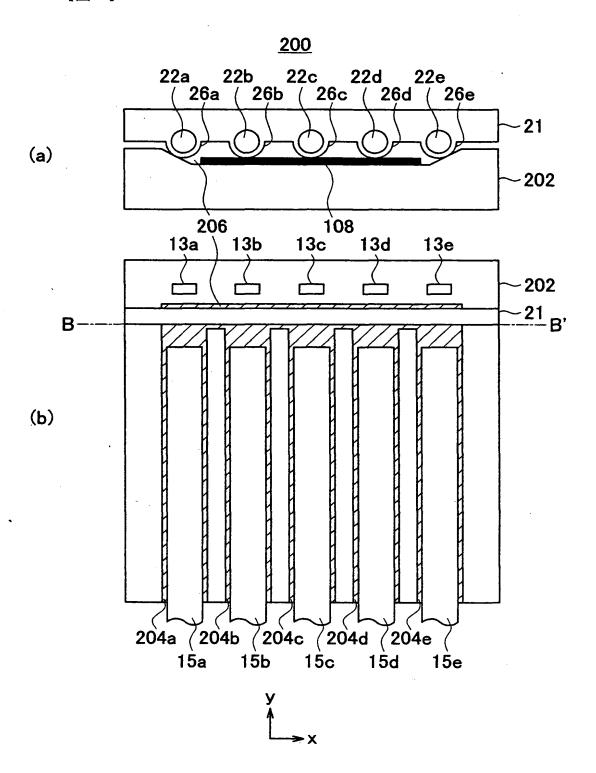
【図2】



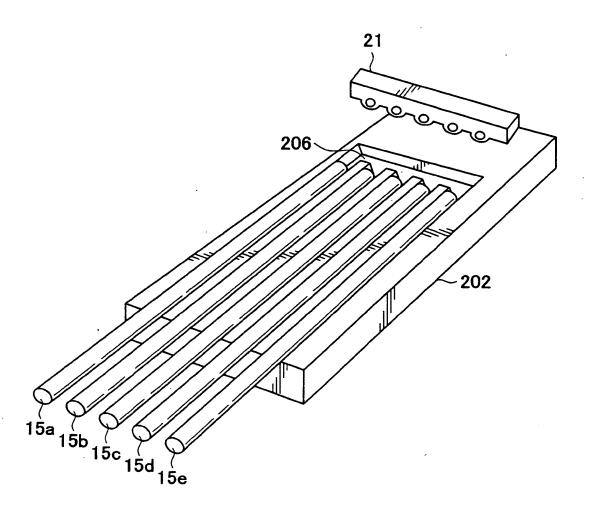
【図3】



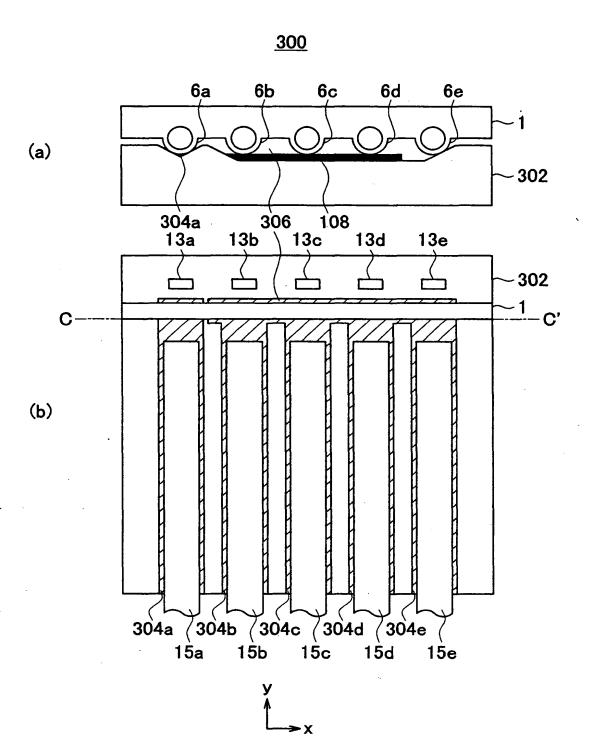
【図4】



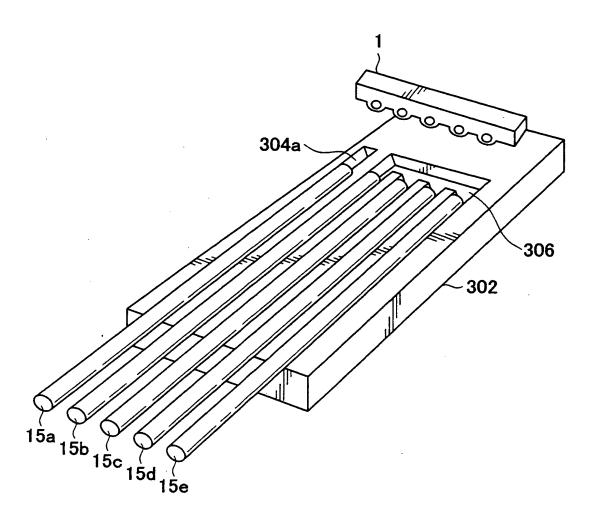
【図5】



【図6】

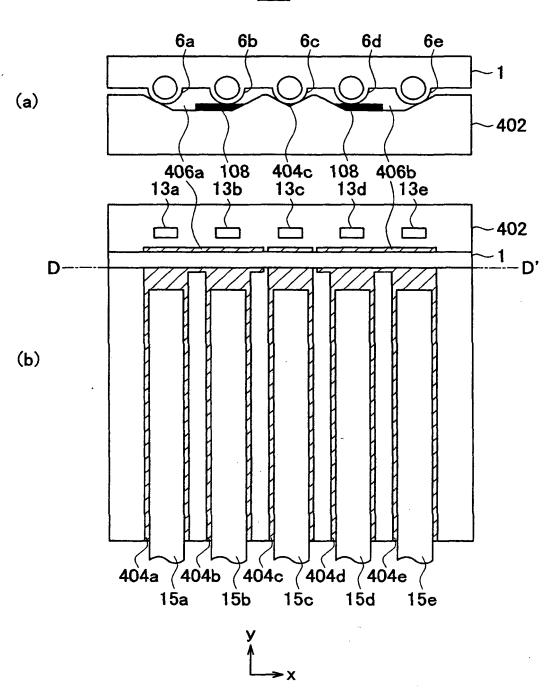


【図7】

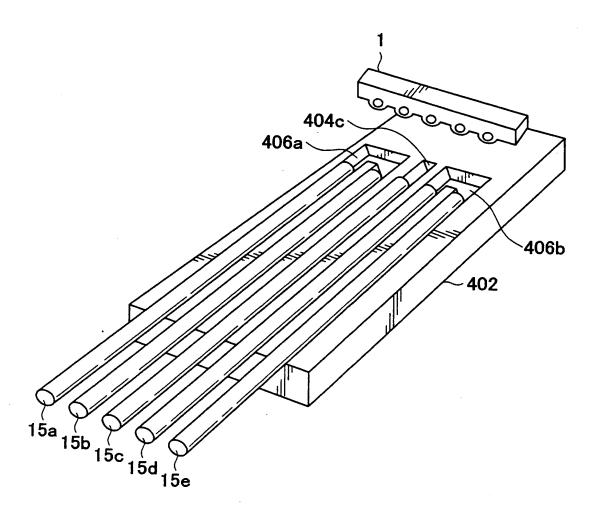


【図8】

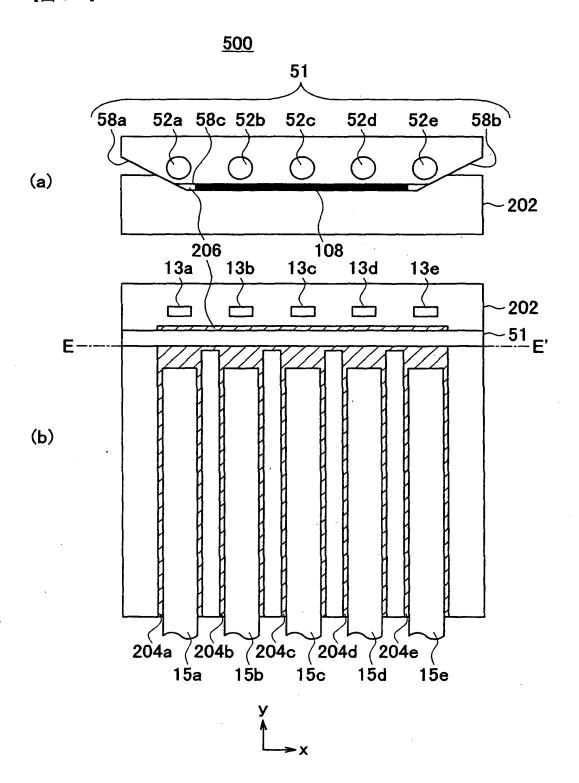




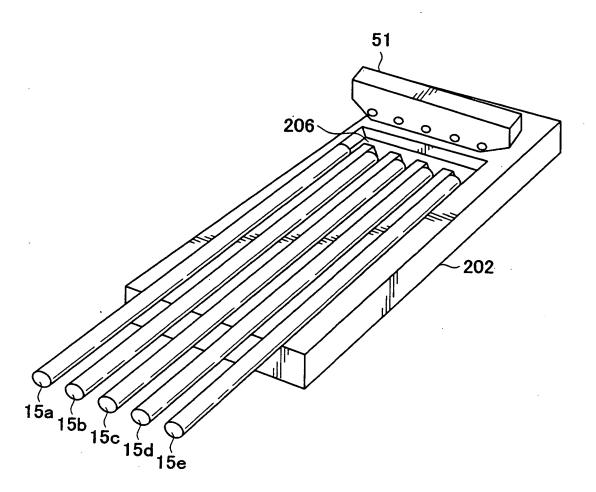
【図9】



【図10】

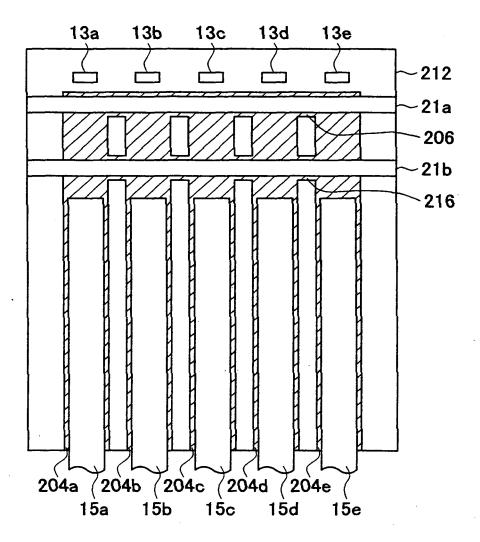


【図11】



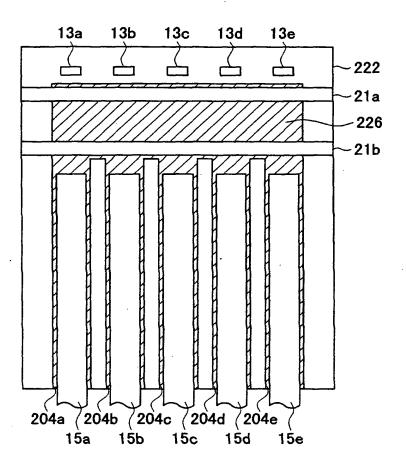
【図12】

<u>210</u>

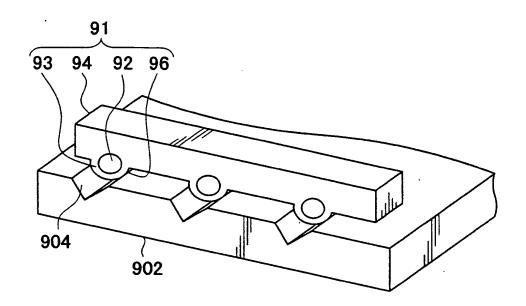


【図13】

## <u>220</u>



【図14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高精度な実装と歩留まりの向上が可能な光学部材の実装方法および高 精度に実装された光モジュールを提供すること。

【解決手段】 レンズアレイ1はレンズ部2a, 2b, 2c, 2d, 2eと各レンズ部ごとに形成された張出部6a, 6b, 6c, 6d, 6eを有する。支持基板102は5つのV溝104a, 104b, 104c, 104d, 104eと, 断面形状が略台形状の凹溝106を有する。レンズアレイ1を支持基板102に実装する際に, 張出部6a, 6eをV溝104a, 104bに接触させて位置決めを行い, 張出部6b, 6c, 6dを凹溝106に非接触に収納して6b, 6c, 6dと凹溝106の間に接着剤108を充填してレンズアレイ1を支持基板102に固定する。

【選択図】 図2

## 出願人履歴情報

識別番号

[000000295]

1. 変更年月日

1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

氏 名

沖電気工業株式会社